

# 사각형 Ptfе 웨이퍼 세정 바스켓 불소고분자 반도체 에칭 랙 맞춤형 실리콘 웨이퍼 캐리어

품목 번호: PL-CP89



## 소개

맞춤형 사각형 PTFE 웨이퍼 세정 바스켓으로 반도체 웨트 벤치 공정을 최적화하십시오. 극한의 내화학성과 고순도 처리를 위해 설계된 이 불소고분자 캐리어는 중요한 실리콘 웨이퍼 에칭 및 세정을 위해 탁월한 내구성과 정밀성을 제공합니다.

## 자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
실리콘 웨이퍼 에칭	표면 층을 제거하거나 특정 질감을 생성하기 위한 산성 에칭전에 기관 침지.	불산 및 질산 혼합물에 대한 탁월한 저항성.
태양전지 세정	도핑 또는 코팅 전 대형 사각형 광전지 웨이퍼의 다단계 세정.	파손을 최소화한 대량 처리 용량.
MEMS 처리	중요한 화학적 릴리스 단계 동안 마이크로 전자기계 시스템 처리.	고순도 환경은 미세 오염을 방지합니다.
초음파 세정	정밀 광학 또는 전자 부품에서 서브 마이크로 입자를 제거하기 위해 초음파 욕조 내 사용.	감쇠 특성은 섬세한 부품을 진동 손상으로부터 보호합니다.
미량 금속 분석	분석 정확도를 위한 고순도 산 욕조에서 실험 기구 준비 및 세정.	PPB 수준 검출을 위한 가능한 가장 낮은 배경 간섭.
LED 기판 처리	공격적인 세정 및 행금 사이클 동안 사파이어 또는 탄화규소 웨이퍼 지원.	고온 화학 공정에서의 장기적인 신뢰성.
화학 저장 및 운송	클린룸 모듈 간 이동 중 민감한 기관의 안전한 수송.	비반응성 표면은 웨이퍼 표면 화학을 보호합니다.
실험실 연구	대학 및 R&D 실험실에서 실험적 재료 처리를 위한 맞춤형 크기의 캐리어.	비표준 실험 설정에 맞는 적용 가능한 설계.

사양 카테고리	PL-CP89 매개변수 세부 정보
모델 식별	PL-CP89
표준 치수	249mm x 249mm (사각형 구성)
재료 구성	100% 고순도 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌)
화학적 상용성	범용 (용융 알칼리 금속 및 불소 원소 제외)
온도 범위	-200°C ~ +260°C (-328°F ~ +500°F)
제작 방법	솔리드 빌릿에서 완전 CNC 가공
웨이퍼 용량	완전히 사용자 정의 가능 (가변 슬롯 수 및 피치)
슬롯 너비	정밀 가공 (웨이퍼 두께에 맞게 사용자 정의 가능)
배수 기능	유체 교환을 위한 통합 베이스 및 측면 유동 포트
핸들 옵션	선택적 분리형 또는 통합 PTFE 핸들 제공
표면 마감	입자 포획을 방지하기 위한 매끄럽고 다공성이 없는 가공 마감

응용 분야	설명	주요 이점
사양 카테고리	PL-CP89 매개변수 세부 정보	
규정 준수	RoHS 규정 준수, FDA 등급 원자재	